

Function 15

Eagle 60

Fully Automatic

Gold Wire Ball Bonder

Revision :

Date :

主画面

画面	参数名称	参数功能	页数
Process Service	0 Bonding Control	包含所有 Bonding 控制之参数设定	
0 Bonding Control	1 Speed Control	包含所有速度方面控制之参数设定	
1 Speed Control	2 PR Control	包含所有图像识别之参数设定	
2 PR Control	3 Looping Control	包含所有线弧控制之参数设定	
3 Looping Control	4 Heater Control	包含所有加热器控制之参数设定	
4 Heater Control	5 Parameter Range Control	包含所有参数控制之设定	
5 Parameter Range Control	6 Statistics Management	包含所有统计数据管理之参数设定	
6 Statistics Management	7 Security Management	包含所有安全密码管理之参数设定	
7 Security Management	8 Misc Control	其它	
8 Misc Control	9 Lot Information	联机用	
9 Lot Information	● Function Code	隐藏编码功能	

Bonding Control...

画面	参数名称	参数功能
Bonding Control...	0 EFO Control	有关 EFO 烧球功能参数控制之画面目录
0 EFO Control	1 Skip Die Control	有关跳过不良品方式参数控制之画面目录
1 Skip Die Control	2 Scrub Control	有关 1, 2 焊点 Scrub 控制之画面目录
2 Scrub Control	3 Bonding Process Control	有关焊接过程控制参数之画面目录
3 Bonding Process Control	4 Safety Control	有关安全设定参数之画面目录
4 Safety Control	5 Bond Stick Detection	有关第一焊点的侦测功能参数之画面目录

5 Bond Stick Detection	6 Butterfly Bond Control	打蝴蝶型之弧度开关
6 Butterfly Bond Control	7 Matrix - IW	改变 Matrix 的打线顺序
7 Matrix - IW	8 Bond Ball Only (F99)	BSOB 或 BBOS 植球开关
8 Bond Ball Only		

● EFO Control...

参数名称	参数功能	内定/范围/注意事项
EFO Control...	0 EFO delay 指停留多少时间后打火	范围: 5 ~ 10 ms
0 EFO delay 5	1 设定 EFO 的时间, 电流, 电压, 球厚等项目	
1 EFO Parameters	2 在这参数下包含所有影响施球的关键性参数	
2 EFO Setting ...	3 设定焊针的数据	
3 Capillary Info...	4 设定不良施球侦测	
4 Ball Formation Monitor...		

EFO Parameter...

画面	参数名称	参数功能	设定/注意事项
EFO Parameter...	0 Unit Type	设定 wire size, ball size, ball thick 单位为 um 或 mil	
0 Unit Type	1 Wire Size	设定金线线径大小	当线径超过 2.0 mil 即属于 heavy wire
1 Wire Size	2 Gap Wide Warning Volt	这是确认 EFO breakdown 电压的容许电压 如 breakdown 电压高过 Gap wire Warning Volt 则机会台会报 "EFO Gap Wide" 警告	
2 Gap Wide Warning Volt	3 FAB Block#	当在 Enable Dual FAB 时, 可在此选择二种 FAB 的 Size, 专用在 BSOB BBOS 中	
3 FAB Block#	4 EFO Current	这参数指融化金线放电时的固定电流总额	
4 EFO Current (*0.01)	5 EFO Time	指放电时间其决定施球之大小。 例如: 时间越长球越大	软体自动计算
5 EFO Time			
6 Ball Size			
7 Ball Thickness			
8 FAB Size			
9 Auto Set Z Parameter			

	6 Ball Size	指焊点上金球的大小	如 F15 EFO Setting/ EFO Control Mode 选择 FAB 则此 2 个参数软件会自动计算
	7 Ball Thickness	指焊点上金球的厚度	
	8 FAB Size	指施球大小	如 F15 EFO Setting/ EFO Control Mode 选择 Capil 则参数软件会自动计算
	9 Auto Set Z Parameter		

EFO Setting...

画面	参数名称	参数功能	设定方式	影响 / 注意事项
EFO Setting***	0 EFO BOX Type	选择放电控制型式其可分为 STD 和 HEAVY	STD : 0.6<线径< 2.0mil Heavy : 1.5<线径< 3.0mil	在硬体方面 STD 与 Heavy 型式其 wire clamp 须更换, EFO BOX 须跳线
0 EFO BOX Type STD				
1 Wire Type Gold	1 Wire Type	线的种类		
2 Auto Calc EFO Time Yes	2 Auto Calc EFO Time	选择 YES. 放电器将根据 EFO Parameter 为依据自动计算打火时间		
3 EFO Control Mode FAB	3 EFO Control Mode	放电控制模式	Capil: 机器将依焊针型式自动计算 FAB. 在这案例中使用者须手动键入焊针数据. FAB: 使用者须手动键入 FAB 数值 FAB2: 其使用在 standoff ball	
4 Enable Dual FAB No	4 Enable Dual FAB	两个不同型式金球的开关	一般设 NO	一般产品设 NO 避免输出大小球
5 Auto EFO Mode Switch NO	5 Auto EFO Mode Switch			

Capillary Info...

画面	参数名称	参数功能	影响 / 注意事项
Capillary Info...			
0 CapillaryPartno _DEFAULT	0 CapillaryPartno	焊针的型号	
1 Vendor Type NONE	1 Vendor Type	焊针的厂家	
2 Load SPT Data	2 Load SPT Data	加载 SPT 厂家焊针的数据	
3 Load Gaiser Data	3 Load Gaiser Data	加载 Gaiser 厂家焊针的数据	
4 Load Micro Data	4 Load Micro Data	加载 Micro 厂家焊针的数据	
5 Load Peco Data	5 Load Peco Data	加载 Peco 厂家焊针的数据	
6 Load Other Data	6 Load Other Data	加载其它厂家焊针的数据	
7 New Capillary Data	7 New Capillary Data	加载新厂家焊针的数据	
8 Delete Capillary Data	8 Delete Capillary Data	删除焊针的数据	
9 Copy Capil Data FLP→HP	9 Copy Capil Data FLP→HP	将磁盘中的焊针数据复制到硬盘中	
A Copy Capil Data HD→Flp	A Copy Capil Data HD→Flp	将硬盘中的焊针数据复制到磁盘中	

New Capillary Data....

画面	参数名称	参数功能	影响 / 注意事项
New Capillary Data...		0 设定焊针下列尺寸的单位	
0 Unit Type 0.1mil	0 Unit Type 0.1mil	1 设定新焊针的型号	
1 capillary Partno _DEFAULT	1 capillary Partno	2 设定新焊针的厂家	
2 Vendor Type NONE	2 Vendor Type	3 设定是否为双 chamfer	

3 Double Chamfer No	3 Double Chamfer	4 设定新焊针 H	
4 Hole Dia: H 15	4 Hole Dia: H	5 设定新焊针 CD	
5 Chamfer Dia:CD 29	5 Chamfer Dia:CD	6 设定新焊针 CA	
6 Chamfer Angle : CA 120	7 Chamfer Angle2 :CA2	7	
7 Chamfer Angle2 : CA2 90	8 Save Capil File	8 储存新焊针档案	
8 Save Capil File			

Ball Formation Monitor....

其目的在防止焊针印打在芯片上，在 Bonding 期间，机器自动将每一个取样信号来比照污染和不良的极限，假如超过这个极限值，则机台将警告 “ Wire Abnormal tail “ or “ E-Torch contamination “

画面	参数名称	参数功能	设定范围	注意事项
Ball Formation Monitor	0 Sample Bonds (Redo)	设定抛球取样数		
0 Sample Bonds (Redo) 30	1 Contamination Level C	设定抛球污染的极限		
1 Contamination Level C	2 Abnormality Level C	设定抛球不良的极限		
2 Abnormality Level C	3Enable BFM No	开启侦测抛球污染与不良的功能		
设定步骤:			使用时机	
步骤 1: 设定取样数			1 更换过焊针后 2 调整过 E-torch 后 3 调整过 Fire level 后	
步骤 2: 设定 Contamination level				
步骤 3: 设定 Abnormality level				
步骤 4: 开启 Enable BFM 为 YES				
步骤 5: 开始 Auto Bond 系统自动计算比对				

● Skip Die Control

画面	参数名称	参数功能	设定范围	注意事项
----	------	------	------	------

Skip Die Control		0 Skip Bad Die	只要有 PR Fail 发生就 Skip unit, (包含 Die, Lead)		
0 Skip Bad Die	NO	1 Skip Missing Die ...	有 Die PR Fail 发生就 Skip unit		
1 Skip Missing Die		2 Skip Ink Unit	此功能专提供给 Skip ink die 教读 INK 图案大小的设定		
2 Skip Ink Unit		3Skip by Special Pat	PR 搜寻找不到所教读之特殊图像就跳过此 unit		
3 Skip by Special Pat		4 Skip by Rej_Indicator			
4 Skip by Rej_Indicator		5 Max Skipped Die Ctrl...	设定连续跳过多少 die 停机		
5 Max Skipped Die Ctrl...		6 Skip Non Stick Die Ctrl			
6 Skip Non Stick Die Ctrl		7 Skip Bad Die	必须先有 lead PR Fail, 检查是否为 Ink Die 再 Skip unit		
7 Skip Bad Die	No	8 Skip Multi_ref per unit	根据图形决定是否 Skip unit		
8 Skip Multi_ref per unit	No				

Skip Missing Die

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Skip Missing Die ...	0 VLL Before Check Ink	在确认 INK Mark 前是否作 VLL	Yes / No	切记一定要教读在 good die 上
0 VLL Before Check Ink	Yes			
1 Skip Missing Die	1 Skip Missing Die	Skip missing die 的开关	Yes / No	
1 Skip Missing Die	No			
Missing Die 设定步骤				
Step 1: index good die 至熟板				
Step 2: 进入 Skip Missing Die 按 enter, 十字线会自动移至 die 的中央				
Step 3: 调整灯光				
Step 4: 教读 die pattern				
Step 5: 直至看到屏幕上弹出 "locate die inside template" 将十字线移至图像中央, 按 enter 即可				

Skip by Special Pat ...

画面	参数名称	参数功能	注意事项
Skip by Special Pat***	0 Check Special Pat	开启/关闭利用特殊图像判别跳过 unit 之功能	
0 Check Special Pat YES	1 Teach Special Pat...	教导特殊图像	
1 Teach Special Pat...	2Skip (If Pat Not Found)	假如找不到特殊图像就跳过	
2Skip (If Pat Not Found) YES	3 Skip (If Pat Found)	假如找到特殊图像就跳过	
3 Skip (If Pat Found) NO			
4 Double Chk with Mean.Pat			
Skip Special DIE 设定步骤			使用时机
Step 1 : index good die 至热板			
Step 2 : 进入 Teach Special Pat 按 enter , 十字线会自动移至 die 的中央			
Step 3 : 调整灯光			
Step 4 : 教导 Lead pattern			
Step 5 :按 enter 即可			

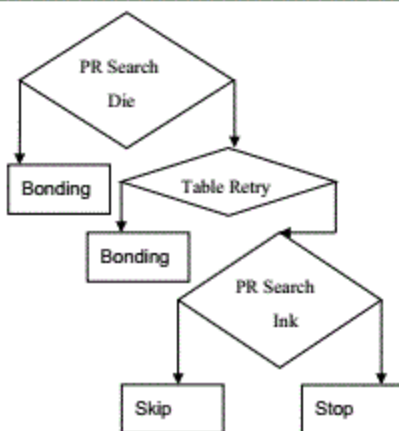
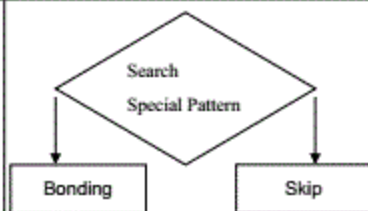
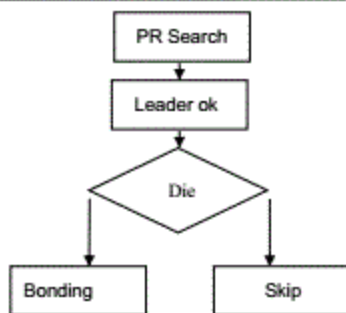
Skip By Mark Checking...

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Skip By Mark Checking...	0 Skip die By Mark Check			
0 Skip die By Mark Check NO	1 Ink Size (Radius)			
1 Ink Size (Radius) 50 Pix	2Chk Rej – Indicator only			
2Chk Rej – Indicator only No	3Teach Reject Indicator			
3Teach Reject Indicator				
Skip By Mark 设定步骤			使用时机	

Max Skipped Die Ctrl...

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Max Skipped Die Ctrl**	0 Max Continuous Skip Die	最多可以连续跳过多少 die 后停机		
0 Max Continuous Skip Die 30	1 Check Max Skip Die Num	是否开启上述功能开关		
1 Check Max Skip Die Num Disable	2 Max Skip Die / Strip	一条 LF 最多可以跳过多少 unit		
2Max Skip Die / Strip 100	3 Strip Skip Die Control	是否开启上述功能开关		
3 Strip Skip Die Control No	4 Reset Skip Die Counter !	清除已经跳过 die 的计数		
4 Reset Skip Die Counter !				

Bad Die



Scrub Control

画面	参数名称	参数功能	注意事项
Scrub Control***	0 1 st BND Scrub Settings...	一焊点 Scrub 的参数设定	wire parameter / edit scrub control 须开启
1 2 nd Bnd Scrub Setting...	1 2 nd Bnd Scrub Setting...	二焊点 Scrub 的参数设定	

1st BND Scrub Settings

画面	参数名称	参数功能	设定
1 st BND Scrub Settings	Scrub Start Offset (SPC)	在第一点 Offset 多少距离 (负值为向第一点做 offset)	
0 Scrub Start Offset (SPC) Enc	0 Period of a Scrub cycle	Scrub 的周期时间	
1 Period T1 (Smp1)/Cycles	1 Period T1 (Smp1)/Cycle	Scrub 的周期数目	
2 Scrub Amplitude Enc	2 Scrub Amplitude	Scrub 的振幅	
3 Amplitude Ration(Y>0,X<0) %	3 Amplitude Ration(Y>0,X<0)		
4 Y Scrub Delay Smp1	4 Y Scrub Delay		
5 Scrub Z Delay Smp1	5 Scrub Z delay	Z 轴的延迟时间, Scrub Z delay = T * 4 * Cycle + 20 + SPC Times)	
6 SPC Speed %	6 SPC Speed	Scrub 速度	
7 SPC Delay Smp1	7 SPC Delay	SPC, SPC2 的延迟时间	
8 Scrub End Offset(SPC2) Enc	8 Scrub End Offset(SPC2)	Scrub 完成后再加一 Offset 距离 (负值为向第一点作 Offset)	
9 Scrub Direction X	9 Scrub Direction	Scrub 的方向	
A Scrub Force 0gm	A Scrub Force	控制第一焊点之 Scrub 的 Force	
B Scrub Power 0	B Scrub Power	控制第一焊点之 Scrub 的功率	

2nd Bnd Scrub Setting ...

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
2 nd Bnd Scrub Setting	0 Scrub Control Mode	选择 Scrub 模式		
0 Scrub Control Mode	1 Scrub Start Offset (SPC)	在第二点 Offset 多少距离 (负值为向第一点做 offset)		
1 Scrub Start Offset (SPC) Enc	2 Period(T1)/ Cycles	Scrub 的周期时间/Scrub 的周期数目		
2 Period T1 (Smp1)/Cycles	3 Amplitude	Scrub 的振幅		
3 Amplitude Enc	4 Scrub Z Pos	Z 轴提高的多少距离		
4 Scrub Z Pos	5 Scrub Z delay	Z 轴的延迟时间, $\text{Scrub Z delay} = T * 4 * \text{Cycle} + 20 + \text{SPC Times}$		
5Scrub Z Delay Smp1	6 SPC Speed	Scrub 速度		
6 SPC Speed %	7 SPC Delay	SPC, SPC2 的延迟时间		
7 SPC Delay Smp1	8 Scrub End Offset (SPC2)	Scrub 完成后再加一 Offset 距离 (负值为向第一点作 Offset)		
8 Scrub End Offset(SPC2) Enc	9 Scrub Direction	Scrub 的方向		
9 Scrub Direction X only	A Scrub Contact Force	控制第二弹点之 Scrub 的 Contact Force		
A Scrub Contact Force	B Scrub Contact Power	控制第二弹点之 Scrub 的功率		
B Scrub Contact Power				

Bond Process Control

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Bond Process Control	0 Ctact Srch Threshold 1/2	对第一点, 第二点 Contact Search 的 Speed Tolerance		
0 Ctact Srch Threshold 1/2 32				
1 1 st Wire Power Offset				

0 2 1st Wire Time Offset 5ms 3 Release Power 0 4 Release Force 0 5 Tail Break Energy 50 6 Pwr Compensation Method 7 Auto Ctact Srch Setup... 8 Bond Enhancer ... 9 Constant Wire Feed Ctr	1 1 st Wire Power Offset	只要机台有所置再重新 Bonding 时, 针对第一条线的 Power 做补偿		
	2 1 st Wire TimeOffset	只要机台有所置再重新 Bonding 时, 针对第一条线的 Time 做补偿		
	3 Release Power	对第一点 Base Power 打下去后开始放的 Power		
	4 Release Force	对第二点 Base Force 打下去后开始放的 Force		
	5 Tail Break Energy	指留完线尾后输出之 power		
	6 Pwr Compensation Method	使用者可以使用此功能来补偿 2 焊点的超音波输出 power 和 force factor , 这个 factor 主要用来排除传统对 X 轴方向的惯性, 改善 2 焊点的形状和 2 焊点的黏着性	Wire Direction	
	7 Auto Ctact Srch Setup...	自动调高的参数设定		
	8 Bond Enhancer ...	指二段式输出 contact srch tol		

Enhancer ...

画面	参数名称	参数功能	注意事项
Bond Enhancer	0 First Bond Enhancer***	一焊点的二段 contact search tol 之目录	
0 First Bond Enhancer*** 1 Second Bond Enhancer***	1 Second Bond Enhancer***	二焊点的二段 contact search tol 之目录	

First Bond Enhancer...

画面	参数名称	参数功能	注意事项
First Bond Enhancer *** 0 Enhancer Mode None 1 Enhancer Power Enhancer Time Enhancer Delay	0 Enhancer Mode None	指第一焊点的的二段 contact Search Tol 的模式	
	1 Enhancer Power	针对一焊点的第二段 contact Search Tol 之输出 power	

Second Bond Factor...

画面	参数名称	参数功能	注意事项
Second Bond Factor*** 0 Enhancer Mode None 1 Enhancer Power 2 Enhancer Power Factor Enhancer Time Enhancer Delay	0 Enhancer Mode None	指第二焊点的的二段 contact Search Tol 的模式	
	1 Enhancer Power	针对二焊点的第二段 contact Search Tol 之输出 power	
	2 Enhancer Power Factor	针对二焊点的第二段 contact Search Tol 之输出 power 的补偿	

Auto Ctact Srch Setup ...

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Auto Ctact Srch Setup*** 0 Search Mode disable 1 Search Tolerance 32 2 Search Speed 128 3 Search delay 160 ms 4 Search Level -150 5 Ref Ctact Level Retry	0 Search Mode disable	是否开启自动测高的功能		此自动测高功能为先在 lead 上测高, 再利用此高度计算 die 的高度
	1 Search Tolerance 32	搜寻的容许值		
	2 Search Speed 128	搜寻的速度		
	3 Search delay 160 ms	指在搜寻高度上的延迟时间		
	4 Search Level -150	搜寻的高度		

7 Search Wire Map 8 Base Power Offset 9 Base Time Offset	5 Search Wire Map	要开启自动测高功能的线		
--	-------------------	-------------	--	--

Safety Control

画面	参数名称	参数功能	设定/注意事项
	0 Bond Pt Tol Ctrl Flag	Bond Pt Tol 开关	
Safety Control	1 Edit Bond Pt Tol (um)	以 Master Program 所教读的程序为标准, 设定 1st / 2nd Bond Position 所容许的偏移范围 放在 'edit bond point' 和 'VLL' reload 或 search 操作者只能在这容许的偏移范围内修改焊点位置	一般设定 15 ~ 3 um 如设定 0 表示关闭此功能
0 Bond Pt Tol Ctrl Flag			
1 Edit Bond Pt Tol (um) 0 0			
2 Check BndPt Overlap			
3 BndPt Overlap Tol			
4 Upper Ctact Srch Tol 1/2 20 20			
5 Lower Ctact Srch Tol 1/2 20 20			
6 Wire End Detection No			
7 Device Oxidize Limit Time 0			
8 Heater Limit Time			
9 Memory Verify Warn Msg			
A Manual Align Pt Auto Chk			
	2 Check BndPt Overlap	BndPt Overlap 开关	
	3 BndPt Overlap Tol	检查 2nd Bond 位置是否有重迭	1.1mil 约设 30
	4 Upper Ctact Srch Tol 1/2	如图, Bond Head 在 1st / 2nd Bond 的 A 范围内有 Contact 信号, 机台显示 Contact Error	一般设定 20
	5 Lower Ctact Srch Tol 1/2	如图, Bond Head 在 1st / 2nd Bond 的 B 范围内仍然没有 Contact 信号, 机台显示 Contact Error	一般设定 20
	6 Wire End Detection	Wire End Sensor 感应到金线是否警告金线快用完的开关	一般设定 Yes
	7 Device Oxidize Limit Time	LF 送到 Heater 后, 多久时间机台没有动作, 则 window clamp 自动打开, 避免 LF 氧化	

	8 Heater Limit Time		
	9 Memory Verify Warn Msg	Memory Verify 讯息显示开关	一般设定 Enable
	A Manual Align Pt Auto Chk	快速改机时 PAD 框会自动对 DIE 的四个角落	

Bond Stick Detection

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Bond Stick Detection	0 Applied Voltage	指 Bond Stick Detection 的实际应用电压		此功能在侦测第一焊点的黏着性
0 Applied Voltage 40 DAC	1 Threshold Voltage	指设定开回路, 闭回路侦测黏与不黏的电压极限		
1 Threshold Voltage 11 DAC	2 Total Sample	指使用者在此功能下设定取样的样品数		
2 Total Sample 20	3 Enable Sample	Sample 开关		
3 Enable Sample No				

Speed Control

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Speed Control	0 Speed Percentage	这参数控制所有机台动作的速度 100%控制速度的倍率(金机台)		
0 Speed Percentage 100 %	1Search Speed 1	在 1st Bond 上 Bond Head 在 Search Height1 的速度。这速度将影响 1st Bond 上的 impact force。		
1Search Speed 1 512	2 Search Speed 2	在 2nd Bond 上, Bond Head 在 Search Height2 的速度。这速度将影响 2nd Bond 的 impact force。		
2 Search Speed 2 640				

PR Control

画面	参数名称	参数功能
PR Control	0 Substrate PR Compensate ...	Substrate PR Compensate 的目录
0 Substrate PR Compensate ...	1Fast PR	YES 表示在 Auto Bonding 一段时间后屏幕不在显示 PR 的图形, 达到节省时间的功能
1Fast PR YES	2 PR Align Scan Mode	
2 PR Align Scan Mode Low	3 PR Tolerance Retry	假如 PR alignment fail, 机器将会重试
3 PR Tolerance Retry 1	4 PR Reload Control	假如 PR Quality fail 是否允许操作者重新 reload PR
4 PR Reload Control Disable	5 PR Auto Threshold	PR 自动调整明亮度
5 PR Auto Threshold Enable	6 PR Table Retry Step	PR Fail 时, PR 扩大多少 step 范围 Search 一次
6 PR Table Retry Step 100 Step	7 VLL Eye Point Update	Enable 当 VLL 寻找失败时, 可以 update 打点位置
7 PR Table Retry Loops	8 VLL Auto Threshold	VLL 自动调整明亮度
8 VLL Eye Point Update Enable	9 VLL Manual Correct	手动调整 VLL 扫描的位置
9VLL Auto Threshold Enable	A Unique PR Retry Step	PR Fail 时, 扩大 Retry 寻找的 step 模式
A VLL Manual Correct Yes		
B More ...	B More ...	B 待续

Substrate PR Compensate

画面	参数名称	参数功能	设定	影响 / 注意事项
Substrate PR Compensate	0 Substrate PR Compensate	Enable: 做亮 Lead 上 PR alignment 后并且发现 lead alignment 点偏移, 机器将自动补偿去找到 die 的 alignment 点		
0 Substrate PR Compensate No				
1 Max Table Retry Range No	1 Max Table Retry Range			
2 Average die Align Pos Yes	2 Average die Align Pos	假如开 yes, 则 S/W 会自动计算偏移 DIE 位置的平均值		

More

画面	参数名称	参数功能	影响 / 注意事项
More***	0 Digital Zoom on Die	其目的在改善手动对点 die alignment 使其更精确的对准。让使用者可以明确的辨别出芯片上图像的边缘	只影响 die 的手动 alignment, lead 不受影响
0 Digital Zoom on Die No			
1 Auto Pad Zoom Mode Disable	1 Auto Pad Zoom Mode	Auto Pad 时是否把图像放大	
2 Auto Pad Search Mode Normal	2 Auto Pad Search Mode	Shape: 影像看灰阶 Normal: 影像看黑白对比	
3 Auto Pad Search Delay 30ms	3 Auto Pad Search Delay	每搜寻一个 pad 之前要 delay 多久	
4 Smart Manual Alignment Disable	4 Smart Manual Alignment	先用手动对点去计算 PR 坐标位置后, 再找 Bonding 位置	
5 Detect Wrong Die / Lead No	5 Detect Wrong Die / Lead		
6 1" Bond Image Display Disable	6 1" Bond Image Display	焊完一个 unit 后, 在 PR 屏幕上显示第一点的图像	
7 PR Dist Integrity Check Disable	7 Distance check		
8 PR Placement Control	8 PR Table Retry Loop		
9 Advanced PR Techniques			
A More			

	9 Advanced PR Techniques		

More

画面	参数名称	参数功能	影响 / 注意事项
More***	0 Power feature Load		
0 Power feature Load Enable			
1 Unique PR Retry Step 0	1 Unique PR Retry Step		
2 Grey Pat Double Load Disable	2 Grey Pat Double Load		

Looping Control

画面	参数名称	参数功能	设定	注意事项
Looping Control***				
0 Advance Loop Control Enable	0 Advance Loop Control	控制是否使用 Advance Loop		
1 Horizontal Length Factor 0	1 Horizontal Length Factor			
2 Reverse Dist 2 Factor 0	2 Reverse Dist 2 Factor	指针对所有 loop mode 的 Reverse Dist 2 作补偿		
3 View Looping Enable No	3 View Looping Enable			

Heater Control

画面	参数名称	参数功能
Heater Control	0 Heater Setting	使用者须要进入此功能设定加热器表面装置种类, 且软件将反应其设定
0 Heater Setting	1 Temperature Show	使用者可监控真正的温度
1 Temperature Show	2 MENU Heater Disable	开启后, 则会在 Bond 屏幕的右下角显示温度
2 MENU Heater Disable Enable		

Heater Setting

画面	参数名称	参数功能
Heater Setting	0 Select Heater	选择加热器表面装置的种类 Heater. → AT bond site Pre-heat → Before Bond site to raise the substrate temperature before ac Post Bond. → After Bond site to maintain the temperature for inspection Fort Heater → 此功能专门应用在 Power Device (例 TO220) Over Hang → this situated on top of the pre-heater to conserve the heat Heater2 → 此功能预留给将来应用之设定
0 Select Heater	1 Temperature Type	使用者可自行选择温度单位
1 Temperature Type C Deg	2 Set Temperature	此功能提供使用者自行设定加热器温度 注意: 设定完温度后, 须作 Heater Auto Tune
2 Set Temperature	3 Heater Alarm	使用者可自行设定加热器的上下限温度, 如超过此温度, 则机器将 alarm
3 Heater Alarm 5 Deg	4 Set Temp. Offset	此功能在补偿设定加热器温度与实际量测之温度不同时之补偿 注意: 设定完此功能后须作 Heater Auto Tune
4 Set Temp. Offset (* 0.1) 0 Deg	5 Heater Auto Tune	此功能在提供加热控制校正至指定的加热温度 注意: 当更换加热器或更改设定温度时须作此功能
5 Heater Auto Tune	6 Set MOTEK Offset	
6 Set MOTEK Offset	7 Set MOTEK Gradient	
7 Set MOTEK Gradient 0	8 On/Off MOTEK OFF	此功能为 Heater Control 之开关
8 On/Off MOTEK OFF	9 Display PID Parameter	
9 Display PID Parameter		

A Heater Protection

画面	参数名称	参数功能
A Heater Protection		
0 Dyn Protect Temperature		
1Dispaly Dyu Prot Curve		
2 Static Prot Temperature		
3 Learned Static Prot Lmt		
4 Learn Heater Protection		
5 Advanced Settings		

Advanced Settings

画面	参数名称	参数功能
Advanced Settings		
0 Dyn Heater Protect Time		
1 Static Prot BandLimit		
2 Num of Points to Capture		
3 Static Prot Delay Time		
4 Manual Static Prot Lmt		
5 Use Manual Static Prot		

Parameter Range Control

画面	参数名称	参数功能	注意事项
Parameter Range Control...	0 Set Bond Para Range ...	设定所有的 Bond Parameter 内的调整范围	其范围设定方式 左: 下限 右: 上限
0 Set Bond Para Range ...	1 Set Base Para Range ...	设定所有的 Base Parameter 内的调整范围	
1 Set Base Para Range ...	2 Set EFO Setting Range ...	设定所有的 EFO 内的调整范围	
2 Set EFO Setting Range ...	3 Loop Mode Lock Setup ...	设定所有 Loop Mode 开关与否	
3 Loop Mode Lock Setup ...	4 Bond Group Range Control	设定所有 Bond Group 开关与否	
4 Bond Group Range Control	5 Loop Group Range Control	设定所有 Loop Group 开关与否	
5 Loop Group Range Control	6 Set Loop Parameter Range	设定所有的 Loop Parameter 内的调整范围	
6 Set Loop Parameter Range	7 Set BSOB Parameter Range	设定所有 BSOB 植球的 Time Power Force 参数调整范围	
7 Set BSOB Parameter Range	8 Set BBOS Parameter Range	设定所有 BSOB 焊球的 Time Power Force 参数调整范围	
8 Set BBOS Parameter Range	9 Load/Save Range Date	储存所有参数调整	
9 Load/Save Range Date	A Lock Parameters ...	锁住所有参数调整	
A Lock Parameters ...			

Statistics Management

画面	参数名称	参数功能
Statistics Management	0 Index Accuracy Statistic	输送定位点位置的统计, 此功能仅提供 ASM Production
0 Index Accuracy Statistic	1 BQM Statistics Control	1 指检查 BQM 的阻抗之目录
1 BQM Statistics Control	2 Reset Statistics	2 重新设定统计次数
2 Reset Statistics	3 Reset Error Log	3 重新设定 Error Log 次数
3 Reset Error Log	4 Select MTBA / MTBF Event	4 选择设定 MTBA / MTBF 的故障事件
4 Select MTBA / MTBF Event	5 Stats Operation Mode	5 选择统计模式
5 Stats Operation Mode Prodn	6 Stats Display Interval 5sec	6 更新屏幕统计数字的时间
6 Stats Display Interval 5sec		
7 Set PM date 200211221329		

8 Set Installation date	7 Set PM date 200211221329	7 设定预定作 PM 的时间
9 Enable Material Problem No	8 Set Installation date	8
A Refresh After Indexing Yes	9 Enable Material Problem	9 Material Problem 开关
	A Refresh After Indexing	A Bonding 后立即更新

BQM Statistics Control

画面	参数名称	参数功能
BQM Statistics Control	0 Enable BQM SPC	开启检查 BQM 是否在 SPC 内的功能
0 Enable BQM SPC	1 Report BQM SPC Error	显示 BQM SPC 错误(机台检测到错误时会停下来) 假如发生 SPC 错误时, 机器将会停下并显示"Statistic Process error"并且询问使用者是否要作校正, 然后开启 auto bond Yes: 当发生 SPC 错误时, 机器将自动停下来等待使用者 Tune BQM Boars No: 当发生 SPC 错误时, 机器将自动作 Tune BQM 代替停止
1 Report BQM SPC Error No	2 Hours Check BQM 1	多久检查一次 BQM SPC
2 Hours Check BQM 1		

Security Management

画面	参数名称	参数功能
Security Management	0 Change Security Password	设定密码
0 Change Security Password	1 Browse Security Password	浏览所 level 1 到 level 4 的密码
1 Browse Security Password	2 Function Key Password	Function 密码
2 Function Key Password	3 Backup F995 To Floppy	将 F995 密码备份到磁盘
3 Backup F995 To Floppy	4 Restore F995 Form Floppy	将 F995 密码加载机台
4 Restore F995 Form Floppy		

Function Key Password

画面	参数名称	参数功能	设定	影响 / 注意事项
----	------	------	----	-----------

Substrate PR Compensate	0 Key 7/9 Stick Detection	Auto Bond Main 内 7/9 Stick Detection 是否要设密码		
0 Key 7/9 Stick Detection Disable				
1 Key 6 Bond Tip Offset Disable	1 Key 6 Bond Tip Offset	Auto Bond Main 内 6 Bond Tip Offset 是否要设密码		

Misc Control

画面	参数名称	参数功能
Misc Control	0 Set Date & Time	设定计算机的日期、时间
0 Set Date & Time	1 Bond Time Scale	时间的单位(1ms, 0.5ms)如将 1ms 切换 0.5ms 则 Bond Time Contact Time 数值会自动变二倍
1 Bond Time Scale 1ms	2 Skip Row / Col Map	
2 Skip Row / Col Map	3 Capillary Control	其功能指刚开始 bonding 时, 有多少条线须要加 power 的补偿。注意:其设定值为 100 条线的倍数。故当补偿 100 条线后, 机器将自动恢复原有 power 设定。
3 Capillary Control	4 Index Test Position	此功能仅供 ASM in-Housing 测试用
4 Index Test Position No	5 Num Unit off Panel Light	指 Bonding 多少个 unit 后关闭 Panel Light
5 Num Unit off Panel Light 10	6 Change EMS Mode	0
6 Change EMS Mode 2-Sig C	7 Set TimeZone(GMT+hh: mm)	-Sig A、1- Sig B、2- Sig C 专门给加装 Equipment Monitoring System 使用格林威治时间设定
7 Set TimeZone(GMT+hh: mm)	8 Programmable Focus	
8 Programmable Focus	9 Screen Saver Time	Bonder PC 屏幕保护模式几分钟后开启
9 Screen Saver Time	A Picture Management	更改图片
A Picture Management	B More	
B More		

More ...

画面	参数名称	参数功能	设定	影响 / 注意事项
----	------	------	----	-----------

More...	0 Lighting Compensation			
0 Lighting Compensation Disable	1 Recalibrate Lighting			
1 Recalibrate Lighting	2 Auto Contact Srch	自动测高的开关		
2 Auto Contact Srch	3Correct Bond	补线线的开关		
3Correct Bond Yes	4 Power Save Mode	待机模式开关		
4 Power Save Mode Disable	6 The Row & Col Pitch			
5 Position Counter	7 Flow Meter Control			
6 The Row & Col Pitch Auto	8 Color with Display	在 Auto 画面下不同的 loop mode, 其虚拟线是否使用不同颜色		
7 Flow Meter Control	9 Cold Start Wire Bonder	清除 Bonder PC 内旧有资料		
8 Color with Display Disable	A Cold Start PR-WH Only	清除 PR-WH 内旧有资料		
9 Cold Start Wire Bonder				
A Cold Start PR-WH Only				
B More				

More ...

画面	参数名称	参数功能	设定	影响 / 注意事项
More...				
0 Reset Table Thermal Prot				
1 Machine Dependent Ctrl				
2 Copy Key Log To Floppy	Copy Key Log To Floppy	可记录按键历史数据		